

# 台湾の経済

熊本の経済・社会に大きなインパクトを与えたTSMC(台湾積体回路製造)の県内進出。その「台湾(中華民国)」の概要を2回シリーズで取り上げる。今回は経済面について探る。

## 1 GDP(域内総生産)

台湾は、台湾本島や多数の島嶼とうしょも含めた総面積が3万6千km<sup>2</sup>と九州本島と同程度である。人口は約2,319万人で、域内のGDPは約7,750億米ドル(2021年)と、ともに九州の1.8倍程度の規模となっているが、一人当り名目GDPでは2万9,868米ドル(2020年度)と九州よりもやや低い(図表1)。ICTを活用した優れた防疫体制をいち早く構築したことでコロナ禍の影響も少なく、2021年の成長率は前年のほぼ倍の6.57%となった(図表2)。

## 2 貿易

台湾は世界のICT産業で重要な役割を果たすとともに、個人・家庭向けの様々な製品でも主要なサプライヤーである。2021年には台湾の輸出額は約4,464億米ドルとなり、世界貿易機関(WTO)によると世界第16位の輸出規模に相当し、輸入額においても約3,812億米ドルと第17位となった。外貨準備高も5,484億米ドル(2021年12月時点)と世界のトップ5に入るレベルとなり、国際経済において重要な地位を占めている。

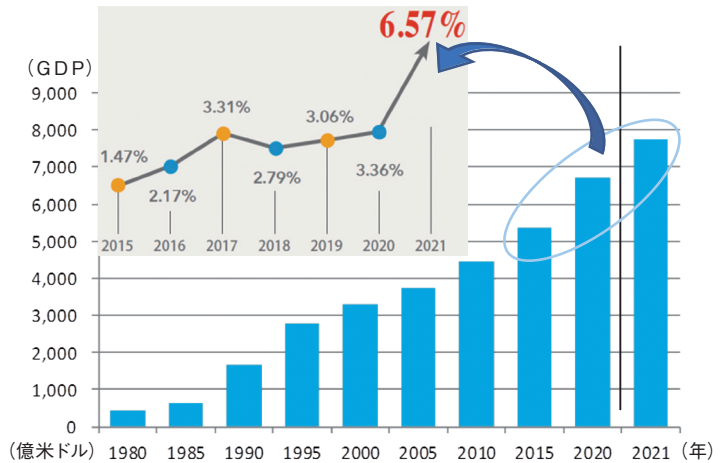
国別の経済的な結び付きでは、中華人民共和国との関係が深く、現在では最大の輸出入相手となっている。日本とは現在でも活発な交易が行われており、経済関係は維持されている(図表3)。また、観光客・留学生などの人的往来のほか、芸能や漫画・アニメ等のコンテンツといった文化面の交流も拡大しており、親日の友好的関係が続いている。

図表1 台湾と九州との比較

	台湾	九州
面積 (km <sup>2</sup> )	36,197	36,783
人口 (万人・2022年6月)	2,319	1,265
域内の総生産 (10億米ドル・2020年度)	673	418
一人当たりの生産額 (米ドル・2020年度)	29,868	32,726

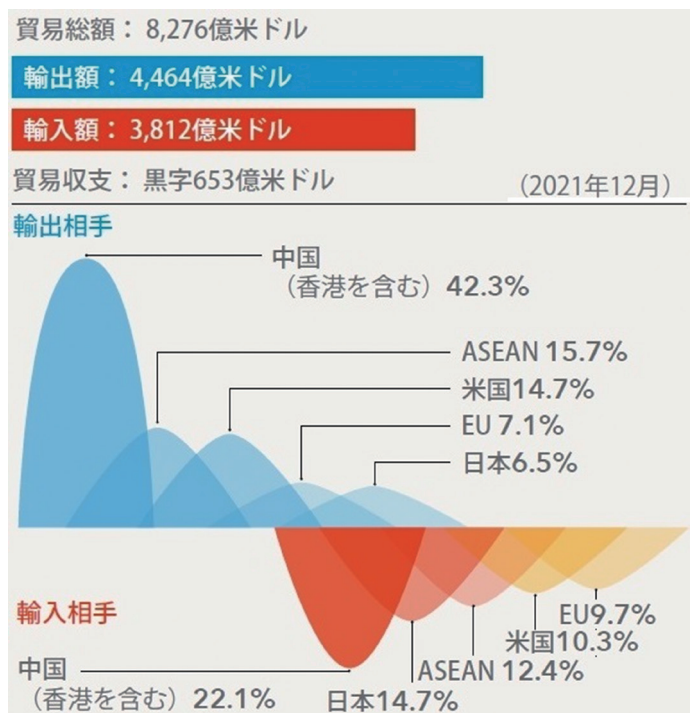
資料：中華民国(台湾)外交部「台湾のしおり2022-2023」、内閣府「県民経済計算」等から当研究所で作成

図表2 台湾の経済規模の拡大と成長率



資料：中華民国(台湾)外交部「台湾のしおり2022-2023」、IMF HPから当研究所作成

図表3 台湾の対外貿易関係



資料：中華民国(台湾)外交部「台湾のしおり2022-2023」

### 3 経済成長の歴史と半導体産業

台湾の現在の経済繁栄は、国連脱退に追い込まれるなどの様々な国際関係の危機に対する努力の賜物といわれている（図表4）。特に1973年の、産業構造を農業・軽工業主体から重工業主体へ転換を図った6ヵ年計画「十大建設」と産業技術研究開発機構である「工業技術研究院」の存在が大きい。同院により半導体の基幹産業化を目指す積極的政策が推進され、在米華僑技術者の協力を得て半導体産業の育成に成功した。

1990年代には世界各国のパソコン企業からOEM<sup>\*</sup>生産を受注し、猛烈なスピードで技術力を向上させて世界的なIT需要に対応したことにより、台湾の経済規模が拡大していった。

2000年代には大手パソコンメーカーの製品内で使われるマザーボードの生産シェアが世界一となった。これまでの受託生産による成功が後の聯華電子（UMC・1980年設立）や台湾積体回路製造（TSMC・1987年設立）、また日月光進團（ASE・1984年）を半導体製品の水平分業による国際的な巨大企業へと成長させる基礎となった（図表4・5）。

台湾の半導体企業は、技術革新を続けながら、世界大手の様々な企業からの受注生産をOEMからODM<sup>\*</sup>、更にはEMS<sup>\*\*</sup>へと高度化させて成長を続けてきた。

このほか、1985年のプラザ合意による猛烈な円高で日本が輸出を大幅に減らしたことで、高度な金属加工技術の確立により高級自動車の輸出を伸ばすなど、様々な産業の技術向上させた。以後も台湾は世界

図表4 台湾の半導体産業の歩み

年	事項
1965	ベトナム戦争（～1975）が激化。米国からの戦略物資の特需を得て台湾経済は飛躍的に発展。
1971	台湾が国連から脱退。
1972	米ニクソン大統領訪中、日中共同声明により、日本との国交が断絶し、国際社会から孤立。
1973	6ヵ年計画「十大建設」に着手。経済主体を農業・軽工業から重工業への転換を目指す。大規模インフラ整備が政策の柱に 台湾最大の産業技術研究開発機構「工業技術研究院」を設立。半導体の基幹産業化を目指す。
1975年頃	欧米の大企業からOEM・ODMの受注が拡大、様々な製品で設計・生産の技術向上を続け、現在の経済発展に繋げていく。
1980年代	中小企業にも電子工業の発展が波及。台北～新竹圏に家電・電子部品関連の企業が集積、発展。
1980	聯華電子（UMC）設立：半導体チップ製造ファウンドリ
1984	日月光進團（ASE）設立：半導体パッケージング
1985～	高度な加工技術を確立し、プラザ合意を背景に金属製品の輸出を拡大。半導体製造の高度化にも寄与。
1987	台湾積体回路製造（TSMC）設立：半導体チップ製造ファウンドリ
1990年代	半導体産業へ水平分業が拡大。世界的なIT需要に乗って経済拡大を続ける。
2000年代	大手PC企業の製品内マザーボードのシェアが世界トップに。
2010	中国と台湾海峡の兩岸経済協力枠組協定（ECFA）に調印。双方間の経済・貿易関係が制度化、拡大。
2010年代～現在	半導体ファウンドリ業態が国際的地位を獲得、拡大。

資料：当研究所作成

図表5 台湾の代表的な世界シェアトップの半導体企業



半導体ファウンドリ

半導体パッケージング

以降は会員専用ページにて公開しております。

※OEM：委託先のブランド・設計による受託生産サービス、  
ODM：委託先の設計請負による委託先ブランドの受託生産サービス、  
EMS：電子組立サービス

図表6 代表的な世界シェアトップのカテゴリー

ご覧頂くには、入会手続き後、会員専用ページより

### 4 半導体産業の現状

アクセスをお願いします。

このほか、1985年のプラザ合意による猛烈な円高で日本が輸出を大幅に減らしたことで、高度な金属加工技術の確立により高級自動車の輸出を伸ばすなど、様々な産業の技術向上させた。以後も台湾は世界

[ご入会はこちらから](#)

(入力は数分で終わります)

[会員の方ははこちらから](#)